

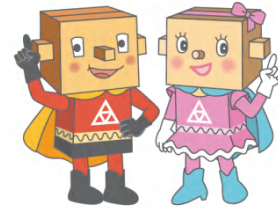
関係各位

レンゴー株式会社  
広報部広報課

## 「エコプロ 2016～環境とエネルギーの未来展」出展のご案内

レンゴー株式会社（本社：大阪市北区、会長兼社長：大坪 清）は、今年も「エコプロ 2016」に出展いたします。

当社ブースでは「段ボールの森」をテーマに、当社の製品づくりのキーワード“Less is more.”を体現する、人にも環境にも優しいパッケージの数々をご紹介します。是非来場の上、当社ブースへお立ち寄りいただきますようご案内申し上げます。



エコプロ 2016 概要 <http://eco-pro.com/2016/>

会 期 2016年12月8日(木)～10日(土) 10:00～18:00 (10日は17:00まで)  
会 場 東京ビッグサイト (東京国際展示場)  
主 催 (一社) 産業環境管理協会、日本経済新聞社

レンゴーブースの主な展示内容 ブースNo. 東3ホール 3-012

- ・段ボールリサイクルの仕組みと優れた特徴の数々
- ・開封やディスプレイが容易で販売促進効果も高い「レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング (RSDP)」
- ・ジャパンスター賞を受賞した「ラックパ ディスプレイ」ほか、日本パッケージングコンテスト受賞作品
- ・耐水、防炎、防湿など、さまざまな機能性段ボール
- ・段ボールベッドなどの防災関連製品
- ・FSC 認証製品



以上